

电子胶底部填充胶武汉威尔德通电子科技有限公司

产品名称	电子胶底部填充胶武汉威尔德通电子科技有限公司
公司名称	武汉威尔德通电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区国家地球空间信息产业基地 区第6期商品房第A-2幢/单元4层6号房
联系电话	17098078208

产品详情

电子胶-----底部填充胶性能参数表

HT8087，低温固化，可返修

w3513，单组份环氧，用作可维修底部填充

W3517，低温快速固化底部填充适合于CSP或BGA封装

w3608，可返修，固化时为焊点提供优良的机械保护。

w3810，

w3705，